

“チップレット”の調査レポート
好評につき、第2弾を緊急発刊!!

チップレット×チップゼネコン× 中小ファブレス設計企業 最新動向調査レポート ～半導体産業構造転換の最前線～

編集 山本 隆浩

半導体技術コンサルタント『サーフテクノロジー』代表



●体裁: B5判 86頁/PDF版【CD or ダウンロード】 ●ISBN:[冊子]978-4-86043-984-2 C3050 [電子]978-4-86043-987-3
●定価: 本体50,000円+税 冊子+PDFセット(本体70,000円+税) ●発刊日: 2025年11月

- ◆ 微細化の先につながる新たな半導体製造技術として注目される「チップレット」。
- ◆ 機能ごとの細分化による設計・製造の分業が進む中、複数のチップレットをまとめて1つの製品を完成すべくプロジェクトを統括する「チップレットゼネコン」。
- ◆ 大手企業の背後にいた「中小のファブレス設計企業」が大きなビジネスチャンスとして、培ってきた技術や知財を活用して、他社連携そして市場参入へ至る道筋を詳報する1冊!

主な目次

1. チップレット技術の基本と進化
2. 「チップゼネコン」という新業態
3. 中小ファブレス設計企業のチャンスと課題
4. チップレット・エコシステムの構築
5. 事例研究：日本発の中小ファブレスとその挑戦
6. 未来シナリオとビジネス戦略
7. 現場から描く半導体産業の未来地図
8. チップレット時代における中小ファブレス(エンジニア、セールス)の今後の方針

(株)エヌ・ティー・エス行 FAX:047-314-0810/E-mail: eigyo@nts-book.co.jp
冊子版()部/PDF版【CD or ダウンロード】()部 PDF版: 冊子版と同価格

申込要領

■直接小社宛にメール、FAX、またはホームページにてお申し込み下さい。送料は無料です(国内に限ります)。
■お支払い方法
商品到着後、銀行振込、郵便振替にてお支払い下さい。
■お申込み先・お問い合わせ先
(株)エヌ・ティー・エス営業部
◆市川 AI センター
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-3-3 アロー本八幡52番館4階
TEL:047-314-0801/FAX:047-314-0810
E-mail: eigyo@nts-book.co.jp
◆本社
〒102-0091
東京都千代田区北の丸公園 2-1 科学技術館 2階
TEL: 03-5224-5430/FAX: 03-5224-5407

購入申込書

団体名

所在地

部署名

氏名

通信欄

〒

TEL

E-mail

株式会社 エヌ・ティー・エス

ここにご記入いただいた個人情報は、下記目的のために利用されます。
(1)お客様との契約の履行、管理 (2)新規書籍及びセミナーの紹介等、当社の営業内容の紹介 (3)お客様にとり有用と思われる当社提携先の書籍・サービス等の紹介
尚、弊社における「個人情報のお取り扱いについて」及び、「個人情報保護方針」については弊社 HP をご覧ください。

第1章 チップレット技術の基本と進化

- 1-1. はじめに：なぜ今チップレットか
- 1-2. チップレットとは何か：定義と構造
- 1-3. 技術的進化：モノリシックとの比較
- 1-4. チップレット技術の進化段階
- 1-5. 技術的課題とブレイクスルー
- 1-6. チップレットの経済的・産業的意義

第2章 「チップゼネコン」という新業態

- 2-1. チップゼネコンの定義と役割
- 2-2. チップゼネコンの複数存在
- 2-3. リーダーゼネコンについて
- 2-4. システム統合とパッケージングの変革
- 2-5. 実例：米AMD、TSMCの事例に見る兆候
- 2-6. チップゼネコンが担うサプライチェーン中核

第3章 中小ファブレス設計企業のチャンスと課題

- 3-1. これまでの立ち位置と制約
- 3-2. チップレットによる分業構造の恩恵
- 3-3. 専門IPの商用化と差別化戦略
- 3-4. 専門IPの実例
- 3-5. 技術力とネットワークが競争力に
- 3-6. 結論

第4章 チップレット・エコシステムの構築

- 4-1. オープンインターフェースと標準化の意義
- 4-2. マーケットプレイス構想と部品供給の変化
- 4-3. プラットフォーム事業者と設計企業の連携

4-4. 商流・知財・検証モデルの再定義

第5章 事例研究：日本発の中小ファブレスとその挑戦

- 5-1. 日本国内の注目プレイヤー
- 5-2. 専門チップレット製品の開発例
- 5-3. 大手とのアライアンス形成事例
- 5-4. 地域連携・大学・政府支援の活用例
- 5-5. 未来展望：日本の中小ファブレスメーカーにおける技術と市場

第6章 未来シナリオとビジネス戦略

- 6-1. チップレット主導の産業構造モデル
- 6-2. 中小企業が取べきポジショニング戦略
- 6-3. チップレット製品ユースケースの進化形態
- 6-4. 課題：品質・供給責任・量産体制
- 6-5. 持続的な競争優位の確立へ

第7章 現場から描く半導体産業の未来地図

- 7-1. 現場から進める民間主導の半導体再生への取り組み
- 7-2. 多様なプレイヤーと共に築く産業の新しいつながり
- 7-3. 量産化に向けた品質・供給・体制づくりの課題
- 7-4. 現場発で生み出す持続的な競争力

第8章 チップレット時代における中小ファブレス(エンジニア、セールス)の今後の方針

- 8-1. 仕事の違い：モノリシックからチップレットまで
- 8-2. 将来に向けた進路：プレゼンスの拡大
- 8-3. 新たな課題とその乗り越え方
- 8-4. 結論：エンジニアとセールスの事例

関連書籍のご案内



量子ドット技術の最新動向

2023年ノーベル化学賞受賞で注目の半導体「量子ドット」量子ドットの作製・制御・信頼性向上の最新研究を解説。ディスプレイ・太陽電池・レーザー・光源・量子コンピュータ・生体への応用研究等についても紹介!

●監修：豊川 泰彦(東京大学/東京大学名誉教授)
●体装：B5 436頁 ●ISBN:978-4-86043-876-7 C3050
●定価：本体58,000円+税 ●発行：2025年9月



チップレットの最新動向 調査レポート

微細化の先につながる新たな半導体製造技術として注目の「チップレット」開発スピード、歩留まりなど微細加工技術の高度化で見えてきた課題解決に向けて技術開発の現状を知る1冊!

●著者：山本 隆浩(半導体技術コンサルタント「サーフテクノロジ」代表)
●体装：B5 104頁 ●ISBN:978-4-86043-940-8 C3050
●定価：本体50,000円+税 ●発行：2025年4月



スピントロニクスハンドブック

基礎から応用まで

電荷と磁気(スピン)の両性質を巧みに利用し応用が拡大し続けているスピントロニクス、その研究の基礎から応用まで網羅! 最新の研究成果、材料開発に用いられる先端計測や計算手法も詳解!

●編集：スピントロニクスハンドブック編集委員会
●監修：佐橋 政司(東北大学名誉教授)ほか2名
●体装：B5 760頁 ●ISBN:978-4-86043-842-5 C3050
●定価：本体70,000円+税 ●発行：2023年5月



光と物質の量子相互作用ハンドブック

光(電磁波)と物質(電子)との量子的な相互作用について、基礎理論から応用・展開まで分かりやすく体系・包括的に網羅! 其々の分野で著名な研究者が各章を執筆、基礎事項から最新の研究成果やトピックスも盛り込んだ、読み応えのある貴重なハンドブック!

●監修：豊川 泰彦(東京大学/東京大学名誉教授)
●編集委員：豊川 泰彦ほか5名
●体装：B5 992頁 ●ISBN:978-4-86043-826-5 C3050
●定価：本体70,000円+税 ●発行：2023年3月



次世代パワー半導体の開発・評価と実用化

省エネ等実現のキーデバイス「次世代パワー半導体」¹ SiC、GaN、ダイヤモンド、酸化ガリウムを材料としたその特長と最新の研究動向を詳解! 実用化に向けて課題となる実装、信頼性、EMC問題、EV等への適用についても解説!

●監修：岩室 泰幸(筑波大学)
●体装：B5 414頁 ISBN:978-4-86043-767-1 C3055
●定価：本体54,000円+税 ●発行：2022年2月



2020版 薄膜作製応用ハンドブック

すぐ役立つポリシーで再編集! 基礎を押さえてつマテリアルズ・インフォマティクスや機械学習をはじめとする情報技術、量子効果デバイス、二次元材料の合成法などの新規応用分野も充実!

●監修：権田 俊一(大阪大学名誉教授)
●編集委員：酒井 忠司(東京科学大学)ほか2名
●編集協力委員：宮崎 隆寛(東北大学名誉教授)
●体装：B5 1,570頁 ●ISBN:978-4-86043-631-5 C3058
●定価：本体69,000円+税 ●発行：2020年2月



最新 実用真空技術総覧

真空技術の全てがこの1冊! 基礎から応用まで網羅、現場実務に役立つよう応用技術事例を豊富に多数使用して掲載!

●編集：最新 実用真空技術総覧 編集委員会
●編集委員長：笠井 秀明(明石工業高等専門学校長/大阪大学名誉教授)
●体装：B5 1,096頁 ●ISBN:978-4-86043-559-2 C3043
●定価：本体58,000円+税 ●発行：2019年2月



半導体微細パターニング

限界を超えるポスト光リソグラフィ技術

光リソグラフィ技術を超えるポスト光リソグラフィ技術の開発動向を網羅! ポストムーアに向けた光リソグラフィ技術とその最新技術動向を追!

●監修：岡崎 信次(元・キガフオン(株))
●体装：B5 416頁 ●ISBN:978-4-86043-467-0 C3050
●定価：本体40,000円+税 ●発行：2017年4月

※一部書籍を除き、NTSサイトにて電子試読可能(無料)・PDF版も販売中(冊子版と同価格)